

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2022年2月3日(03.02.2022)



(10) 国際公開番号

WO 2022/024510 A1

(51) 国際特許分類:
C09J 11/04 (2006.01) *H01L 21/52* (2006.01)
C09J 163/00 (2006.01) *H01L 21/301* (2006.01)
C09J 171/00 (2006.01) *C09J 7/30* (2018.01)

(21) 国際出願番号: PCT/JP2021/018947

(22) 国際出願日: 2021年5月19日(19.05.2021)

(25) 国際出願の言語: 日本語

(26) 国際公開の言語: 日本語

(30) 優先権データ:
特願 2020-129493 2020年7月30日(30.07.2020) JP

(71) 出願人: 古河電気工業株式会社(FURUKAWA ELECTRIC CO., LTD.) [JP/JP]; 〒1008322 東京都千代田区大手町二丁目6番4号 Tokyo (JP).

(72) 発明者: 森田 稔(MORITA, Minoru); 〒1008322 東京都千代田区大手町二丁目6番4号 古河電気工業株式会社内 Tokyo (JP).

(74) 代理人: 特許業務法人イイダアンドパートナーズ, 外(IIDA & PARTNERS et al.); 〒1050004 東京都港区新橋3丁目1番10号 石井ビル3階 Tokyo (JP).

(81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH,

CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, IT, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

一 国際調査報告(条約第21条(3))

(54) **Title:** COMPOSITION FOR ADHESIVE, FILM-LIKE ADHESIVE, AND SEMICONDUCTOR PACKAGE IN WHICH FILM-LIKE ADHESIVE IS USED AND METHOD FOR MANUFACTURING SAME

(54) 発明の名称: 接着剤用組成物及びフィルム状接着剤、並びに、フィルム状接着剤を用いた半導体パッケージ及びその製造方法

(57) **Abstract:** The present invention provides: a composition for an adhesive, the composition containing an epoxy resin (A), an epoxy resin curing agent (B), a phenoxy resin (C), and an inorganic filler (D), the phenoxy resin (C) having an elastic modulus at 25 °C of 500 MPa or above, the proportion occupied by the phenoxy resin (C) in the total contained amount of the epoxy resin (A) and the phenoxy resin (C) being 10-60 mass%, and an uncured film-like adhesive formed using the composition for an adhesive having a nanoindentation hardness at 25 °C of 100 MPa or above and a Young's modulus of 100 MPa or above; a film-like adhesive in which the composition for an adhesive is used; and a semiconductor package in which the film-like adhesive is used and a method for manufacturing the same.

(57) 要約: エポキシ樹脂(A)、エポキシ樹脂硬化剤(B)、フェノキシ樹脂(C)及び無機充填材(D)を含有する接着剤用組成物であって、前記フェノキシ樹脂(C)の25℃における弾性率が500MPa以上であり、前記エポキシ樹脂(A)と前記フェノキシ樹脂(C)の各含有量の合計に占める前記フェノキシ樹脂(C)の割合が、10~60質量%であり、前記接着剤用組成物を用いて形成した、硬化前のフィルム状接着剤の25℃におけるナノインデンテーション硬さが0.10MPa以上、ヤング率が100MPa以上である接着剤用組成物、これを用いたフィルム状接着剤、このフィルム状接着剤を用いた半導体パッケージとその製造方法。



WO 2022/024510 A1